



- 晶粒尺寸封裝: 大晶粒、高功率、超小體積
- 內部無接線,無內部空焊問題
- 製作錫球方便裝配使用
- 符合微型化空間小的需求
- 主要封裝尺寸:

封裝型號	尺寸 mil	尺寸(±0.10)mm
MFN3	100*50*20	2.54*1.27*0.40
MFN4	80*50*16	2.32*1.16*0.40
MFN5	62*34*16	1.58*0.86*0.40
MFN5-1	62*34*16	1.58*0.86*0.40
MFN9-1	40*24*16	1.02*0.61*0.40

●主要電性(Electrical Characteristics):

產品類別	主要電性						封裝型號
	Io(A) / W	VF(V)	IFSM(A)	VR(V)	IR(uA) <sub>MAX</sub>	TRR(ns)	
STD/GP	1	0.92	30	600	5		MFN3
	1	1.0	30	600	5		MFN3
FR /HER/SF	1	1.3/1.7/1.7	30	600	5	250/75/35	MFN3
TVS (雙向) (10/1000µs)	90W			6.0 ~ 51	參考目錄		MFN5
	200W			6.0 ~ 51	參考目錄		MFN4
Zener	0.5	1.2V@0.1A	5	10 ~ 100	5 ~ 1		MFN5
	1	1.2V@0.2A	10	10 ~ 100	5 ~ 1		MFN4
SKY	0.2	0.45/TYP.0.40	5	40	50		MFN9-1
	0.3	0.48/TYP.0.44	5	40	50		MFN9-1
	0.5	0.55 /TYP.0.49	5	40	50		MFN9-1
	1	0.45/0.55	20	40	100/50		MFN5-1

●焊錫面設計建議(Suggested Solder Pad Layout):

圖示	代號	SKY		TVS		其他		
		MFN5-1	MFN9-1	MFN4	MFN5	MFN3	MFN4	MFN5
	A	1.70	1.10	2.20	1.70	2.60	2.20	1.70
	B	0.80	0.50	0.97	0.63	1.07	0.97	0.70
	C	0.50	0.40	0.83	0.63	0.82	0.83	0.60
	D	0.70	0.30	0.55	0.45	0.97	0.55	0.50
	E	0.50	0.40	0.83	0.63	0.82	0.83	0.60

- 應用:更輕薄短小二極體元件,符合各類小型化、微型化設計,如行動資訊產品、LED 等需求。